晶晨半导体(上海)股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2025-003

投	资	√特定对象调研 □分析师会议
者	关	□媒体采访 □业绩说明会
系	活	□新闻发布会 □路演活动
动	类	□现场参观
别		□其他 (<u>请文字说明其他活动内容)</u>
参	与	华泰证券
单	位	永赢基金
名和	沵	UBS
		Corbets Capital
		富国基金
		国信证券
		Point 72
		JP Morgan
		Fullerton 富敦投资
		信安资产管理
		Aspex Management
		磐泽资产
		BNP Paribas asset management
		Invesco
		UBS Asset Management
		广发基金
		淡水泉投资
		Central Asset Investments
		元果投资
		太平基金

Morgan Stanley 长江证券 华泰柏瑞基金 广发证券 交银

浩成资产管理有限公司 长江证券(上海)资产管理有限公司 国融基金管理有限公司 东财证券 金信基金管理有限公司 东吴证券股份有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司

东止圆私募基金管理有限公司 上海博笃投资管理有限公司

申万菱信基金管理有限公司

Schroder Investment Management (Hong Kong)Limited 上海顺领资产管理中心(有限合伙)

上海一村投资管理有限公司 国联安基金管理有限公司 宏利基金管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 上海远海私募基金管理有限公司 上海道仁资产管理有限公司 华方私募基金管理(上海)有限公司 百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司

新华基金管理股份有限公司 长城基金管理有限公司 深圳市尚诚资产管理有限责任公司

光大证券股份有限公司 中邮创业基金管理股份有限公司

和谐健康保险资管

深圳中天汇富基金管理有限公司 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

西南证券

国投证券

上海嘉世私募基金管理有限公司

重阳投资

华泰资产管理有限公司

华泰证券(上海)资产管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

华泰证券股份有限公司

施羅德投資管理(香港)有限公司

逸原达投资

中邮保险资产管理有限公司

海富通基金管理有限公司

西南证券股份有限公司

泰信基金管理有限公司

Point72 Hong Kong Limited

国投证券股份有限公司

HUATAI SECURITIES

创金合信基金管理有限公司

汇丰晋信基金管理有限公司

厦门财富管理顾问有限公司

中信证券

大湾区发展基金管理有限公司

IGWT Investment

西部利得基金管理有限公司

GIS HUND

上海东方证券资产管理有限公司

平安证券股份有限公司 上海明汯投资管理有限公司 国海证券股份有限公司 东方红资产管理有限公司 大成基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 宏利投資管理(香港)有限公司 上海益和源资产管理有限公司 湘财证券股份有限公司 毕盛(上海)投资管理有限公司 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 农银人寿保险股份有限公司 宝盈基金管理有限公司 鑫巢资本 远策投资 国信证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 九泰基金 丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 中国人民养老保险有限责任公司 鹏扬基金管理有限公司 上海睿郡资产管理有限公司 上海瀚伦私募基金管理有限公司 东方证券 中金公司 信达澳亚 长信基金管理有限责任公司

财通证券

光证资管

中泰证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 淳厚基金管理有限公司 华源电子 民生证券 瑞银证券有限责任公司 中欧基金管理有限公司 LyGH Capital 嬴舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资 华源证券
淳厚基金管理有限公司 华源电子 民生证券 瑞银证券有限责任公司 中欧基金管理有限公司 LyGH Capital 嬴舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
华源电子 民生证券 瑞银证券有限责任公司 中欧基金管理有限公司 LyGH Capital 嬴舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
民生证券 瑞银证券有限责任公司 中欧基金管理有限公司 LyGH Capital 贏舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 春康基金 招银理财 华盛投资
瑞银证券有限责任公司 中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司 LyGH Capital 嬴舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
LyGH Capital 贏舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
赢舟资产管理有限公司 深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
深圳丞毅投资管理有限公司 长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
长江养老 银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
银华基金 Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
Grandeur Peak Global Advisors 国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
国联安 宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
宝盈基金 长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
长城基金 兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
兴全基金 泰康基金 招银理财 毕盛投资
泰康基金 招银理财 毕盛投资
招银理财毕盛投资
毕盛投资
华源证券
工银瑞信
时间 2025 年 11 月
地点 线上会议、线下接待
上市
公司
接 待 董事、董事会秘书: 余莉女士
人员
姓名

投者系动要容绍资关活主内介

1、整体经营数据

答: 营收规模: 2025年前三季度实现营业收入50.71亿元,同比增长9.29%, 创历史同期新高;其中第三季度单季营收17.41亿元,同比增长7.20%。

盈利水平: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 6.98 亿元,同比增长 17.51%; 2025 年前三季度,公司因股权激励确认的股份支付费用为 0.15 亿元,对归属于母公司所有者的净利润的影响为 0.22 亿元(已考虑相关税费影响),剔除上述股份支付费用影响后,2025 年前三季度归母净利润为 7.20 亿元;基本每股收益 1.66 元/股,同比增长 16.90%。

盈利能力: 综合毛利率持续改善,前三季度整体达 37.12%,同比提升 0.75 个百分点,其中一季度 36.23%、二季度 37.29%、三季度 37.74%,呈现逐季优化趋势。

研发投入: 前三季度研发费用合计 11.18 亿元,同比增长 9.64%,研发投入占营业收入比例 22.05%,同比提升 0.07 个百分点,持续保持高强度研发投入。

2、公司 2025 年前三季度整体业绩增长,核心驱动因素是什么?

答: 2025年前三季度公司实现营收 50.71亿元,同比增长 9.29%;归母净利润 6.98亿元,同比增长 17.51%。核心驱动因素:一是端侧智能技术渗透率提升以及 WiFi 6、新一代工艺制程芯片、自研算力芯片、智能视觉芯片等新品销量持续扩大形成共振,带动产品销售规模扩大,前三季度营收创下历史同期新高;二是运营效率持续改善,综合毛利率从一季度的 36.23%逐季提升至三季度的 37.74%,前三季度整体达 37.12%,综合毛利率的绝对值同比增长 0.75个百分点,盈利能力稳步增强。

3、第三季度单季度业绩环比有所下滑,主要原因是什么?该影响是否 会持续?

答: Q3 业绩环比承压主要受存储芯片缺货涨价影响,部分面向国内运营商市场的产品延迟提货,属于短期行业环境导致的订单节奏波动。但该部分订单确定性较高,将延后到后续季度逐步释放。尽管存在短期订单延迟,但核心

增长动力未发生变化,不会对公司业绩增长趋势产生实质性影响。

4、公司新一代工艺制程芯片自 2024 年下半年商用以来表现亮眼,前三季度出货量及全年预期如何?

答: 新一代工艺制程芯片上市后呈加速发展态势,2025 年前三季度销量近 700 万颗,市场认可度持续提升。基于目前的订单节奏和客户拓展进度,预 计全年销量有望达到千万颗规模。在大规模商用验证之后,后续新一代工艺制程技术还将继续应用于公司即将推出的更高算力的通用端侧平台系列。

5、公司端侧智能相关产品表现突出,出货量大幅增长,核心驱动因素 是什么?未来增长动力及后续产品规划是什么?

答:端侧智能已成为公司核心增长引擎之一,2025年前三季度业务放量成效显著。前三季度,搭载公司自研端侧智能算力单元的芯片出货量突破1400万颗,同比增幅超150%,且已有20余款商用芯片完成公司自研端侧算力单元的搭载适配,覆盖公司多条核心产品线。

该类业务实现大幅增长的核心驱动力,源于端侧智能技术在全球市场的快速渗透,且未来仍具备爆发式增长潜力,主要依托两大方向:

- 1. 存量场景赋能升级:原有智能终端品类借助端侧智能技术实现迭代,需求持续释放。例如,公司与谷歌联合推出适配 Gemini 端侧大模型的智能摄像头、可视化门铃等产品,助力其智能家居产品向内嵌端侧大模型能力的新一代产品升级,进一步激活存量市场需求。
- 2. 增量场景开拓延伸:端侧智能催生全新应用形态与场景,打开增量空间。比如,公司与三星在智能白电合作基础上,近期再次合作推出 Color E-Paper (彩色电纸)大屏显示产品,该产品凭借超低功耗、易部署的核心优势,在商用显示领域具备广阔前景。同时,公司还与沃尔玛、Insta360等头部客户合作,持续拓展智能安防、AI 会议终端等新兴场景,显著提升公司产品的全球市场覆盖度与订单获取能力。此外,公司将在确定性大市场与增量市场持续挖掘端侧智能技术的应用潜力,多因素将共同推动端侧智能相关芯片出货量继续保持大幅增长。

后续产品布局方面,公司将推出更高算力的通用端侧平台系列,依托公司 芯片方案通用平台的技术特性,将适配更多元化的终端产品与使用场景,进一 步覆盖增量市场的核心需求,巩固端侧智能业务的增长优势。

6、₩系列芯片作为重要增长极,其市场拓展与产品结构有何新变化?

答: W 系列 2025 年前三季度出货超 1300 万颗,同比增长近 70%,其中 Wi-Fi 6 芯片前三季度出货超 400 万颗,Wi-Fi 6 产品销量在 W 系列总体销量的占比从去年同期不足 6%跃升至 30%以上,产品结构持续优化。随着后续 W 系列市场拓展的继续深入、新产品的持续上市以及与公司主控 SoC 平台的配套销售规模进一步扩大,W 系列整体和 Wi-Fi 6 产品的销售规模还将持续扩大。

7、公司 C 系列智能视觉芯片成长显著,前三季度销量达到去年同期两倍,当前 C 系列芯片的订单增长主要依赖哪些下游领域?与知名 AI 平台的适配验证,具体会从哪些方面助力其实现智能视觉领域的爆发性增长?

答: 当前 C 系列智能视觉芯片的订单增长,主要得益于公司在全球范围内的智能摄像头、智能门铃、打猎机、城市安防等领域持续收获新订单,消费级和工业级智能视觉设备需求持续释放。与此同时,通过与全球知名 AI 平台的适配及商用验证,一方面有助于提升 C 系列芯片的技术兼容性和场景适配能力,使得其能更好地满足不同客户的智能化需求;另一方面,借助知名 AI 平台的技术生态、品牌影响力和市场渠道,可快速触达更多国际市场和潜在客户,加速产品的规模化落地,为 C 系列芯片在智能视觉领域实现爆发性增长奠定了坚实基础。

8、公司汽车电子芯片的布局及商业化进展如何?目前已合作哪些车企 及车型?

答:公司深耕汽车电子芯片领域,目前已推出车载信息娱乐系统芯片及智能座舱芯片,高算力新一代工艺制程智能座舱芯片将于近期流片。同时,公司正通过技术整合与创新,打造涵盖智能座舱、辅助驾驶、局域网与广域网融合的"智驾通"一体化 SoC 解决方案,持续完善产品生态布局。

现有车载信息娱乐系统芯片及智能座舱芯片,内置高算力神经网络处理器,支持多系统多屏幕显示功能,可覆盖影音娱乐、导航服务、360全景影像、个性化交互、人机协同、个人助理、DMS(驾驶员监测系统)等应用场景。

在市场合作方面,公司汽车电子芯片已成功进入多家国内外知名车企的供应链体系,其中宝马、林肯、Jeep、沃尔沃、极氪、创维等车企的相关车型已实现量产搭载。

9、前三季度公司毛利率同比有所提升,主要原因是什么?未来毛利率水平能否保持稳定?

答:前三季度毛利率提升至 37.12%,主要得益于:一是产品结构持续优化,高附加值的端侧智能芯片、Wi-Fi 6 芯片、新一代工艺制程芯片等占比持续提升;二是运营效率提升,在 2024 年效率提升年基础上,公司进一步优化供应链管理与成本控制,同时规模化效应逐步显现。后续随着更多效率提升措施落地,公司产品综合毛利率有望保持持续改善趋势。

10、公司在研产品进展如何?

答:在研产品推进顺利: Wi-Fi 路由芯片与 Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片已成功回片,进入内部测试阶段;覆盖 AIoT 与智能汽车领域的高算力新一代工艺制程芯片将于近期流片;智能显示系列首款芯片计划 2025 年底流片。这些布局将进一步完善产品矩阵,打开新的增长空间。

11、 收购芯迈微后的整合工作进展如何? "蜂窝通信+光通信+Wi-Fi" 技术栈的构建将带来哪些战略价值?

答: 芯迈微核心研发团队已完整并入公司体系并开展工作,后续将持续构建公司"蜂窝通信+光通信+Wi-Fi"的多维通信技术栈与产品矩阵,有助于将公司现有产品的应用场景从局域网扩展到广域网。

战略价值:

1. 拓宽技术护城河,完善产品矩阵:该″蜂窝通信+光通信+Wi-Fi″的多维通信技术栈有助于实现公司底层通信技术的全覆盖,将芯迈微在蜂窝通信领域

的技术积累与公司现有光通信、Wi-Fi 优势深度互补,形成"端侧智能+算力+通信"的核心技术架构,面向多应用场景,具有独特竞争力的泛 AIoT 解决方案。同时助力公司 W 系列产品向更高带宽的 Wi-Fi 7, 更低功耗的 Wi-Fi 1 × 1, 更广阔用途的 Wi-Fi 路由产品迭代演进,并丰富超低功耗、可穿戴领域的产品布局。

- 2. 拓展应用场景边界,打开增长空间:凭借"蜂窝通信+光通信+Wi-Fi"的多维通信技术栈优势,公司将 AIoT 产品从智能家居等局域网场景延伸至广域网 AIoT 移动场景,结合公司现有的全球 250 余家运营商渠道,覆盖智慧城市、智慧工农业、公共安全、老幼出行安全等领域。同时适配汽车领域高智能化、高数据量、高算力背景下的"移动+大带宽+多连接"通信需求,助力打造智能座舱、辅助驾驶、局域网与广域网融合的"智驾通"一体化 SoC 解决方案,对标世界级领先方案。
- 3. 实现技术与商业协同,强化竞争力:底层通信芯片与上层应用芯片形成协同效应,既能提升现有平台型 SoC 产品的连接性能与场景适配能力,又能通过 SoC+通信多技术融合的解决方案增强客户黏性,在泛 AIoT 与连接领域构建具有独特竞争力的竞争优势。

12、公司研发投入保持高位,前三季度研发费用达 11. 18 亿元,研发资源主要投向哪些方向?

答:研发投入重点聚焦以下领域:一是端侧智能技术的深度迭代与场景落地,持续提升算力单元性能与适配能力;二是通信连接技术的突破,包括Wi-Fi 6、路由芯片等技术研发;三是新兴领域布局,涵盖智能汽车、智能显示、智能视觉等,同时保障新一代工艺制程等先进制程产品的技术升级与产品迭代。

风险提示:本文如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

接待过程中,公司与投资人进行了充分的交流与沟通,严格遵守公司《信

	息披露管理制度》等文件的规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、
	公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
是 否	
涉及	
应 当	否
披露	
重 大	
信息	
附件	
清单	 无
(如	儿
有)	
日期	2025年11月24日